

บรรณานุกรม

- กันยรัตน์ คมวัชร. (2547). การนำ Six Sigma มาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการศึกษา. วารสาร การประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 5 ฉบับที่ 1, 20-34.
- ธิดิมา พงษ์สังกา “การลดของเสียในโรงงานผลิตเชิงไม้อย่างพาราโดยเทคนิคซิกซ์ ซิกม่า” การ ค้นคว้าแบบอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2551.
- นวลพรรณ ใจงาม “การลดของเสียที่เกิดจากการถ่ายเทกระแสไฟฟ้าสถิต ในกระบวนการประกอบ หัวอ่านโดยใช้ระเบียบวิธีซิกซ์ ซิกม่า” วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542.
- ณัฐเจตน์ เกษมกล “การประยุกต์ใช้ซิกซ์ ซิกม่า ในการลดปัญหาจำนวนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องใน โรงงานอุตสาหกรรม” วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 2550.
- Dusharme, D. (2006). Six Sigma Survey: Big Success... What About Other 98 Percent?. Quality Digest [Online]. Available: http://www.qualitydigest.com/feb03/articles/01_articles.shtml [2008, February 25].
- Hafner, A. W., Ph.D. (2003). Pareto's Principle: The 80-20 Rule. Dean of University Libraries Ball State University [Online], Available: <http://www.bsu.edu/libraries/ahafner/awh-th-math-pareto.html> [2010, October 9].
- Kaushik, P., Khanduja D., Mittal K., Jaglan P., Application of Six Sigma methodology in a small and medium-size manufacturing enterprise. The TQM journal, Vol. 24 No.1, 2012, 4-16, 2008.
- Kumar, U. D., Nowicki, D., Ramirez-Marquez, J. E., Verma, D., On the optimal of process alternatives in a Six Sigma implementation. Int. J. Production Economics, 111: 456-467, 2007.
- Kwak, Y.H., Anbari, F. T., Benefits, Obstacles, and future of six sigma approach. Technovation, 26: 708-715, 2006.
- Lin, C. K., Chen H. C., Li R. K., Chen C. P., Tsai C. H., Research on increasing the production yield rate by Six Sigma method: A case of SMT process main board. The asian journal on quality, Vol. 10, No.1: 1-23, 2005.

- Linderman, K., Schroder, R.G., Choo, A.S., Six Sigma: The role of goals in improvement teams. *Journal of Operations Management*, 24: 779-790, 2006.
- Montgomery, D. C. (2004). *Introduction to Statistical Quality Control*. Arizona State University : Wiley.
- Montgomery, D. C. (2005). *Design and Analysis of Experiments*. Arizona State University : Wiley.
- Mosaica, 2007. *Innovex BB Training Material*. Mosaica Partners, Cleaveland, USA.
- Su, C. T., Chou, C. J., A systematic methodology for the creation of Six Sigma projects: A case study of semiconductor foundry. *Expert Systems with Applications*, 34: 2693–2703, 2008.

ภาคผนวก ก

ตารางการวิเคราะห์ข้อบกพร่องและผลกระทบ

ลำดับ	กระบวนการ	ปัจจัยทางด้าน เข้าที่สำคัญ	แนวโน้มรูปแบบของ การเกิดข้อบกพร่อง	แนวโน้มผลกระทบ จากข้อบกพร่อง	ความ รุนแรง	แนวโน้มสาเหตุของปัญหา	ความถี่ ที่เกิด	การควบคุมในปัจจุบัน	การ ตรวจ พบ	คะแนน ลำดับ ความเสี่ยง	ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา	ความ รุนแรง	ความถี่ ที่เกิด	การ ตรวจ พบ	คะแนน ลำดับ ความเสี่ยง
1	อบงานลงหน้า	อุณหภูมิที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า	อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	ของเสียการล้นขอบ	10	อุณหภูมิที่ใช้สูงหรือต่ำเกินไป เนื่องจากมีการกำหนดค่าไว้ ตายตัว	9	เอกสาร PR12302 Product recipes for biglam lamination	3	270	ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากข้อจำกัด ในการสั่งงานจำนวนมาก (Mass production)	10	9	3	270
2	อบงานลงหน้า	เวลาที่ใช้ในการอบงานล่วงหน้า	เวลาที่ใช้ไม่เหมาะสม	ของเสียการล้นขอบ	10	เวลาที่ใช้มากหรือน้อยเกินไป เนื่องจากมีการกำหนดค่าไว้ ตายตัว	9	เอกสาร BCP12302 Process block control plan for multi panel	3	270	นำไปทำการทดลองหาเงื่อนไขเหมาะสม	10	9	3	270
3	เคลือบแบบ หลายแผ่น	แรงกดที่ใช้ในการเคลือบงาน	แรงกดที่ใช้ไม่เหมาะสม	ของเสียการล้นขอบ	10	แรงดันที่ใช้มากหรือน้อยเกินไป เนื่องจากมีการกำหนดค่าไว้ ตายตัว	9	เอกสาร PR12302 Product recipes for biglam lamination	3	270	นำไปทำการทดลองหาเงื่อนไขเหมาะสม	10	9	3	270
4	เคลือบแบบ หลายแผ่น	อุณหภูมิที่ใช้ในการเคลือบงาน	อุณหภูมิที่ใช้ไม่เหมาะสม	ของเสียการล้นขอบ	10	อุณหภูมิที่ใช้สูงหรือต่ำเกินไป เนื่องจากมีการกำหนดค่าไว้ ตายตัว	9	เอกสาร BCP12302 Process block control plan for multi panel	3	270	ไม่สามารถแก้ไขได้เนื่องจากข้อจำกัด ในการสั่งงานจำนวนมาก (Mass production)	10	9	3	270
5	เคลือบแบบ หลายแผ่น	แผ่นฟิล์มลอกได้ ที่ใช้ในการเคลือบงาน	ใช้แผ่นฟิล์มลอกไม่เหมาะสม	ของเสียการล้นขอบ	10	ใช้แผ่นฟิล์มลอกไม่ตรงกับ ลักษณะของผลิตภัณฑ์	9	เอกสาร PR12302 Product recipes for biglam lamination	3	270	นำไปทำการทดลองหาเงื่อนไขเหมาะสม	10	9	3	270
6	คลึงฟิล์ม	การห่อพลาสติก รัดดัม	ห่องานโดยไม่ใส่สารกักชื้น	ของเสียการล้นขอบ	10	การของฟิล์มดูดซึมความชื้น จนมีค่าสูงเกินไป	9	เอกสาร JA8605 Coverfilm and kapton packing	3	270	กำหนดให้มีการใส่สารกักชื้น (Silica gel) กับกระบวนการรัดดัมทุกกอง	10	3	3	90
7	คลึงฟิล์มดอย	ความชื้นในตู้แห้ง หลังฟิล์มดอย	ความชื้นสูงเกินไป	ของเสียการล้นขอบ	10	การของฟิล์มดูดซึมความชื้น จนมีค่าสูงเกินไป	3	เอกสาร JA12004 Visual aid for coverfilm ly up mini	7	210	นำอุณหภูมิขึ้นแบบใหม่ที่สามารถ ควบคุมความชื้นได้ไม่เกิน 5%RH มา ใช้แทนตู้แบบเดิมที่ควบคุมได้ 20 %RH	10	1	7	70
8	คลึงฟิล์ม	ความชื้นในห้อง คลึงฟิล์ม	ความชื้นสูงเกินไป	ของเสียการล้นขอบ	10	การของฟิล์มดูดซึมความชื้น จนมีค่าสูงเกินไป	3	เอกสาร JA12004 Environment control procedure	7	210	เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความชื้น สัมพัทธ์จากวันละ 1 ครั้งเป็น กระละ 1 ครั้ง	10	1	7	70
9	คลึงฟิล์มดอย	ความชื้นในห้อง คลึงฟิล์มดอย	ความชื้นสูงเกินไป	ของเสียการล้นขอบ	10	การของฟิล์มดูดซึมความชื้น จนมีค่าสูงเกินไป	3	เอกสาร JA12004 Environment control procedure	7	210	เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความชื้น สัมพัทธ์จากวันละ 1 ครั้งเป็น กระละ 1 ครั้ง	10	1	7	70
10	คลึงฟิล์มและรัด งานเป็นแผ่น	ความชื้นในห้อง รัดฟิล์มและรัด งานเป็นแผ่น	ความชื้นสูงเกินไป	ของเสียการล้นขอบ	10	การของฟิล์มดูดซึมความชื้น จนมีค่าสูงเกินไป	3	เอกสาร JA12004 Environment control procedure	7	210	เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความชื้น สัมพัทธ์จากวันละ 1 ครั้งเป็น กระละ 1 ครั้ง	10	1	7	70
11	อบงานลงหน้า	ความชื้นในห้องอบงานล่วงหน้า	ความชื้นสูงเกินไป	ของเสียการล้นขอบ	10	การของฟิล์มดูดซึมความชื้น จนมีค่าสูงเกินไป	3	เอกสาร JA12004 Environment control procedure	7	210	เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความชื้น สัมพัทธ์จากวันละ 1 ครั้งเป็น กระละ 1 ครั้ง	10	1	7	70
12	เคลือบแบบ หลายแผ่น	ความชื้นในห้องเคลือบแบบหลายแผ่น	ความชื้นสูงเกินไป	ของเสียการล้นขอบ	10	การของฟิล์มดูดซึมความชื้น จนมีค่าสูงเกินไป	3	เอกสาร JA12004 Environment control procedure	7	210	เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบความชื้น สัมพัทธ์จากวันละ 1 ครั้งเป็น กระละ 1 ครั้ง	10	1	7	70

ประวัติผู้เขียน



ชื่อ - สกุล

นายปรกรณ์ อุ่นจันทร์

วัน เดือน ปี เกิด

24 เมษายน 2515

ประวัติการศึกษา

- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ปีการศึกษา 2532
- สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
แผนกวิชาช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม จังหวัดกรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2534
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชา
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร จังหวัด
กรุงเทพฯ ปีการศึกษา 2538

ประสบการณ์

2553 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกวิศวกรรมกระบวนการผลิต
บริษัท สมาร์ทแทรค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

2552 – 2553

ตำแหน่ง แบล็กเบลท์ แผนกซิกซ์ ซิกม่า

2547 – 2552

ตำแหน่ง วิศวกรอาวุโส แผนกวิศวกรรมกระบวนการผลิต
บริษัท อินโนเว็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด

2539 – 2547

ตำแหน่ง วิศวกร

บริษัท โตชิบ้า เซมิคอนดักเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

